Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столстовых» (ВлГУ)

<u>Институт прикладной математики, физики и информатики</u> (Наименование института)



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ ОСНОВАНИЙ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ В НАНОЭЛЕКТРОНИКЕ

(наименование дисциплины)

направление подготовки / специальность

28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника

(код и наименование направления подготовки (специальности)

направленность (профиль) подготовки

Нанотехнологии и микросистемная техника

(направленность (профиль) подготовки))

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Проектирование коммуникационных оснований электронных средств в наноэлектронике» является приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков конструкторско-технологического проектирования коммутационных оснований электронных средств различного уровня сложности.

Задачи:

- ознакомить студентов с этапами жизненного цикла, физическими принципами действия, условиями и режимами эксплуатации микроэлектронных приборов и наноэлектронных устройств, с нанотехнологиями и системами автоматизации проектирования электронных средств;
- сформировать у студентов целостное представление о классообразующей приборной структуре и уровнях конструктивной иерархии изделий и элементной базы электронных средств, о типовых конструкциях и технологиях изготовления электронных блоков, узлов и коммутационных оснований, о закономерностях функционирования приборов и их взаимосвязи с параметрами и свойствами материалов и режимами технологических операций процессов изготовления изделий;
- развить практические навыки работы с нормативно-техническими конструкторскими и технологическими документами, проектирования узлов, блоков и коммуникационных оснований, применения методики оценки технологичности конструкторских проектных решений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина «Проектирование коммуникационных оснований электронных средств в наноэлектронике» относится к дисциплинам по выбору части учебного плана.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Проектирование коммуникационных оснований электронных средств в наноэлектронике», соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции					
		Результяты обучения по дисциплине			
УК1. Способен	УК-1.1. Знает принципы сбора,	Знает источники	Практико-		
осуществлять поиск,	отбора и обобщения информации.	информационно-	ориентированные		
критический анализ и	УК-1.2. Умеет соотносить	патентного исследования	задания		
синтез информации,	разнородные явления и	объекта проектирования.	Статьи		
применять системный	систематизировать их в рамках	Умеет систематизировать	Рефераты		
подход для решения	избранных видов	структурные элементы	Отчет по		
поставленных задач	профессиональной деятельности.	конструкции изделий	практической		
	УК-1.3. Владеет навыками научного	электронных средств.	подготовке		
	поиска и практической работы с	Владеет навыками	(приложение 1)		
	информационными источниками;	практической работы с	KP		
	методами принятия решений.	нормативно-техническими			
		документами.			
УК4. Способен	УК-4.1. Знает литературную форму	Знает требования и правила	Практико-		
осуществлять	государственного языка, основы	оформления текстовых	ориентированные		
целовую	устной и письменной	документов.	задания		
коммуникацию в	коммуникации на иностранном	Умеет излагать принятые	Статьи		
устной и письменной	языке, функциональные стили	технические решения в	Рефераты		

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	родного языка, требования к деловой коммуникации. УК-4.2. Умеет выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой коммуникации. УК-4.3. Владеет навыками составления текстов на государственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на родной, опыт общения на государственном и иностранном языках.	устной и письменной форме. Владеет навыками составления текстовых конструкторских и технологических проектных документов.	Отчет по практической подготовке (приложение I) КР
УКб. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	УК-6.1. Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда, УК-6.2. Умеет эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать методы саморегуляции, саморазвития, самообучения. УК-6.3. Владеет способами управления своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных интересов и потребностей.	Знает правила и требования работодателя к соблюдению трудовой дисциплине. Умеет составлять краткосрочные и долговременные планы повышения квалификации. Владеет методами и средствами удаленного доступа к информационным ресурсам повышения квалификации.	ориентированные задания Статьи Рефераты Отчет по практической подготовке (приложение 1) КР
ПК1. Способен проводить физикоматематическое моделирование исследуемых процессов нанотехнологии и объектов нано- и микросистемной техники с использованием современных компьютерных технологий	ПК-1.1. Знает физические и математические законы и модели физических процессов, лежащих в основе принципов действия объектов нанотехнологии и микросистемной техники. ПК-1.2. Умеет решать задачи, использовать математический аппарат и численные методы компьютерного моделирования объектов нанотехнологии и микросистемной техники. ПК-1.3. Владеет математическим аппаратом и методами компьютерных технологий для моделирования объектов нанотехнологии и микросистемной техники.	Знает физико- математические основы моделирования структуры электронных средств. Умеет применять средства компьютерного моделирования при решении конструкторских задач проектирования функциональных узлов. Владеет расчетной методикой компьютерного моделирования и анализа параметров и характеристик объектов нанотехнологии и микросистемной техники.	Практико- ориентированные задания Статьи Рефераты Отчет по практической подготовке (приложение 1) КР

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины «Проектирование коммуникационных оснований электронных средств в наноэлектронике» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов

Тематический план форма обучения – очная

	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				гьная	формы текущего контроля успеваемости, форма
№ п/п				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	в форме практическо й полготовки	Самостоятельная работа	промежуточной аттестации (по семестрам)
1	Назначение, физические основы и материалы элементов и компонентов электронных средств	7	1-6	6	6	12	-	39	рейтинг-контроль 1
2	Структурные и функциональные схемы электронных средств	7	7-12	6	6	12	-	39	рейтинг-контроль 2
3	Средства проектирования, изготовления и контроля электронных средств	7	13-18	6	6	12	÷	39	рейтинг-контроль 3
Всег	о за 1 семестр:	7	1-18	18	18	36	-	117	Экзамен, 27
Наличие в дисциплине КП/КР		7	1-18	-			-	-	зачет (КР)
Итого по дисциплине		7	1-18	18	18	36	=	117	Экзамен, 27 / зачет (КР)

Содержание лекционных занятий по дисциплине

Раздел 1. Физические основы и направления развития, промышленного производства, нанотехнологий, конструкций, элементной базы и коммутационных оснований электронных средств

Тема 1 Физические основы элементов и компонентов электронных средств **Содержание темы**.

Электроника - область науки, техники и производства; физическая, техническая и промышленная электроника; сферы применения и преимущества микроэлектронных средств. Виды физических полей; диапазоны электромагнитных излучений. Типы межзонных и внутризонных энергетических переходов электронов внутри атома с испусканием и поглощением квантов энергии. Генерация и рекомбинация носителей заряда в полупроводниках; длина свободного пробега. Физическая природа составляющих прямого и обратного тока р-п перехода; структурные модели биполярных и униполярных элементов. Гетеропереходы, их структура и основные энергетические диаграммы.

Тема 2 Материалы коммутационных оснований электронных средств **Содержание темы**.

Классификации материалов коммутационных оснований; конструкционные и технологические материалы. Последовательность переработки вещества в изделия электронной техники; получение полупроводниковых материалов по методу Чохральского. Дефекты кристаллических решеток по Френкелю и по Шоттки; растворы внедрения и замещения; диффузия в твердых телах.

Тема 3 Направления развития конструкции и видов производства электронных средств и коммутационных оснований

Содержание темы.

Виды производства - единичный, серийный, массовый; основной и вспомогательный процессы микроэлектронного производства. Этапы жизненного цикла и уровни конструктивной иерархии (входимости) электронных средств. Признаки системности конструкции; соотношение понятий проектирование и конструирование электронных средств. Задачи, цели и техническое задание на проектирование; комплексная микроминиатюризация электронных средств; средства проектирования.

Раздел 2. Функциональные, структурные и принципиальные схемы электронных средств и процессов изготовления коммутационных оснований

Тема 1 Структура электронных средств и коммутационных оснований **Содержание темы**.

Назначение и структурно-функциональные схемы средств электроники, фотоники и оптроники. Функциональные узлы (ячейки), субблоки и блоки электронных средств. Схемы компоновки комплексов и систем. Пассивная и активная элементная база изделий полупроводниковой микроэлектроники; электрорадиоэлементы и устройства функциональной электроники.

Тема 2 Элементы и компоненты изделий микроэлектроники

Содержание темы.

Физическая природа межатомной связи в твердых кристаллических полупроводниках; характеристика ионной, ковалентной и металлической связей в кристаллах. Молекулярные кристаллы; природа дисперсионной, ориентационной и индукционной составляющих взаимодействия сил Ван-дер-Ваальса. Корпусные и бескорпусные цифровые микросхемы на униполярных транзисторах – МОП и КМОП-логика; цифровые микросхемы на биполярных транзисторах.

Тема 3 Элементы и компоненты изделий оптоэлектроники

Содержание темы.

Элементная база изделий оптоэлектроники; источники и приемники излучений. Структура и конструкция светоизлучающих и лазерных диодов, лазерных линеек и матриц. Назначение и физико-технологическая структура фоторезисторов, фотодиодов, фототранзисторов и фототиристоров.

Раздел 3. Режимы, условия эксплуатации и процессы проектирования и контроля коммутационных оснований электронных средств

Тема 1 Микроэлектронные технологии в наноэлектронике

Содержание темы.

Группы интегральных микросхем в едином конструктивно-технологическом исполнении; серии микросхем; полупроводниковая, пленочная, гибридная и смешанная технологии изготовления; микросборки. Тонкопленочные и толстопленочные групповые интегральные технологии. Технология изготовления линеек и матриц лазерных диодов.

Тема 2 Технологии межсоединений элементов и компонентов электронных средств **Содержание темы**.

Технологические процессы межсоединений - коммутационных оснований; объемный и плоскостной монтаж; технология печатного и интегрального монтажа; световоды; волоконно-оптические линии связи. Функционально-узловой, каскадно-узловой, схемно-узловой и моносхемный методы проектирования коммуникационных оснований.

Тема 3 Методы контроля и испытания электронных средств

Содержание темы.

Типовые технологические процессы; рабочее место, производственный участок, цех, технологические операции, переходы, оборудование и оснастка. Виды основных и вспомогательных технологических документов; карты технологического процесса — маршрутные, операционные, эскизов. Методы разрушающего и неразрушающего, прямого и измерительного контроля изделий. Технологичность конструкции изделий; экономические, качественные и количественные показатели конструктивного совершенства — системы коэффициентов и требований. Комплексный показатель технологичности конструкции. Отработка конструкции изделия на технологичность; метод экспертных оценок.

Содержание практических/лабораторных занятий по дисциплине

Раздел 1. Физические основы и направления развития, промышленного производства, нанотехнологий, конструкций, элементной базы и коммутационных оснований электронных средств

Тема 1 Физические основы элементов, компонентов и коммутационных оснований электронных средств

Содержание практических/лабораторных занятий.

Объект, предмет, цель и результат научного исследования в области техники электронных средств, коммутационных оснований и микроэлектронных технологий.

Диапазоны электромагнитных излучений - примеры техники изделий электроники.

Тема 2 Материалы электронных средств и коммутационных оснований

Содержание практических/лабораторных занятий.

Анализ свойств материалов микроэлектронных средств и оптико-электронных блоков и узлов, коммутационных оснований.

Физические основы развития оптико-электронных средств и совершенствования материалов оптоэлектроники.

Тема 3 Направления развития конструкции коммутационных оснований и видов производства электронных средств

Содержание практических/лабораторных занятий.

Производственный и технологический процессы изготовления электронных средств.

Этапы жизненного цикла электронных средств. Примеры профессиональной деятельности бакалавра техники и технологии на различных этапах жизненного цикла электронных средств.

Признаки системности конструкции электронных средств. Уровни входимости конструкции (уровни конструктивной иерархии – элементная база, микросборка, ячейка, субблок, блок, система).

Совершенствование конструкции электронных средств, коммутационных оснований, их основополагающих параметров и характеристик. Соотношение понятий проектирование и конструирование электронных средств. Задачи, цели и техническое задание на проектирование. Средства проектирования.

Определяющие факторы развития конструкций специальных (профессиональных) и электронных средств широкого пользования (бытовых). Исходные данные процесса конструирования электронных средств; электрические схемы электронных средств - структурная, функциональная, принципиальная. Функционально-узловой, каскадно-узловой, схемно-узловой и моно-схемный методы конструирования ячеек электронных средств; социальные предпосылки перехода от «мебельного» к «приборному» стилю конструирования бытовых электронных средств.

Компоновка электронных средств, определяющие факторы. Уровни конструктивной иерархии оптоэлектронных средств мобильной связи.

Раздел 2. Функциональные, структурные и принципиальные схемы электронных средств и процессов изготовления коммутационных оснований

Тема 1 Структура электронных средств

Содержание практических/лабораторных занятий.

Назначение электронных средств и коммутационных оснований. Типовая структура средств фотоники и оптроники.

Исследование структуры электронных средств, уровней конструктивной иерархии, этапов жизненного цикла. Методы проектирования и технологии изготовления элементной базы и коммутационных оснований.

Исследование электрических и волоконно-оптических линий связи, жгутов, оптических кабелей, соединителей и разветвителей. Методы проектирования и технологии изготовления коммутационных оснований.

Тема 2 Элементы и компоненты изделий микроэлектроники

Содержание практических/лабораторных занятий.

Поколения и составные части электронных средств. Совершенствование элементной базы.

Микросборка как подуровень 1-го конструктивного уровня электронных средств.

Тема 3 Элементы и компоненты изделий оптоэлектроники

Содержание практических/лабораторных занятий.

Виды изделий оптоэлектронных средств. Основной и вспомогательный производственные процессы предприятий оптоэлектронного производства.

Структура, параметры и характеристики светодиода. Типовая конструкция светодиода. Типовая конструкция лазерного диода. Типовая конструкция линейки лазерных диодов. Типовая конструкция матрицы лазерных диодов.

Раздел 3. Режимы, условия эксплуатации и процессы проектирования и контроля коммутационных оснований электронных средств

Тема 1 Микроэлектронные технологии в наноэлектронике

Содержание практических/лабораторных занятий.

Прогресс микроэлектронных процессов производства электронных средств, комплексная микроминиатюризация, средства проектирования.

Разработка технологического процесса изготовления деталей оптико-электронных блоков и узлов, коммутационных оснований.

Анализ технологичности конструкции оптико-электронных блоков, узлов и деталей.

Тема 2 Технологии межсоединений элементов и компонентов электронных средств

Содержание практических/лабораторных занятий.

Методика термо-вакуумного формирования теплоотводов на коммутационных основаниях МЛД на установке THEBION EB4P3KWTH2-Ion.

Методика термозвуковой сварки контактов ЛЛД при сборке МЛД на установке K&S 4522.

Методика селективной сборки драйверов МЛД в полуавтоматическом и ручном режимах на установке IR/PL650 ремонтного центра фирмы ERSA.

Технология изготовления коммуникационных оснований микросборок.

Коммуникационные основания электронных средств в виде печатных и интегральных плат. Разновилности плат по технологии изготовления.

Тонкопленочные и толстопленочные технологии формирования проводников и пассивных компонентов на поверхности интегральных плат.

Основные требования к проектированию печатного монтажа, особенности трассировки и расчета элементов печатного монтажа. Преимущества и недостатки диэлектрических оснований печатных плат из гетинакса, текстолита и стеклотекстолита.

Многослойные печатные платы. Особенности монтажа электрорадиоэлементов и устройств функциональной электроники на печатных платах.

Тема 3 Методы контроля и испытания электронных средств

Содержание практических/лабораторных занятий.

Методика измерения спектральных параметров ЛЛД на установке scld-10-ir.

Методика измерения электрических и оптических параметров ЛЛД на установке IELD-8.

Методика контрольно-измерительных операций процесса сборки МЛД.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

5.1. Текущий контроль успеваемости

Вопросов к рейтинг-контролю 1

Назначение коммутационных оснований средств электроники и оптоэлектроники. Виды физических полей. Диапазоны электромагнитных излучений. Получение полупроводниковых материалов по методу Чохральского. Принципы образования энергетических зон в полупроводниках. Этапы жизненного цикла и уровни конструктивной иерархии (входимости) электронных средств. Признаки системности конструкции. Степень интеграции микросхем.

Вопросы к рейтинг-контролю 2

Физическая природа межатомной связи в твердых кристаллических полупроводниках; характеристика ионной, ковалентной и металлической связей в кристаллах. Пассивная и активная элементная база изделий полупроводниковой микроэлектроники. Электрорадиоэлементы и устройства функциональной электроники. Структура и конструкция

светоизлучающих и лазерных диодов. цифровые микросхемы на униполярных транзисторах – МОП и КМОП-логика; цифровые микросхемы на биполярных транзисторах. Элементная база изделий оптоэлектроники; источники и приемники излучений. Структура и конструкция светоизлучающих и лазерных диодов, лазерных линеек и матриц.

Вопросы к рейтинг-контролю 3

Полупроводниковая, пленочная, гибридная и смешанная технологии изготовления микросхем; микросборки. Тонкопленочные и толстопленочные групповые интегральные технологии. Технологические процессы межсоединений - объемный и плоскостной монтаж; технология печатного монтажа; световоды; волоконно-оптические линии связи. Технология изготовления линеек и матриц лазерных диодов. Виды основных и вспомогательных технологических документов; карты технологического процесса — маршрутные, операционные, эскизов. Технологичность конструкторских решений как свойство изделий электроники; экономические, качественные и количественные показатели конструктивного совершенства — системы коэффициентов и требований. Комплексный показатель технологичности конструкции; метод экспертных оценок.

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (экзамен). **Контрольные вопросы**.

- 1. Назначение и структура электронных средств. Типовая структура средств фотоники и оптроники.
- 2. Диапазоны электромагнитных излучений примеры техники изделий оптоэлектроники.
- 3. Этапы жизненного цикла электронных средств. Примеры профессиональной деятельности бакалавра техники и технологии на различных этапах жизненного цикла электронных средств.
- 4. Виды изделий электронных средств. Основной и вспомогательный производственные процессы предприятий микроэлектронного производства.
- 5. Поколения и составные части электронных средств. Элементы и компоненты изделий электроники.
 - 6. Структура, параметры и характеристики светодиода. Типовая конструкция светодиода.
 - 7. Типовая конструкция лазерного диода.
 - 8. Типовая конструкция линейки лазерных диодов.
 - 9. Типовая конструкция матрицы лазерных диодов.
- 10. Совершенствование конструкции электронных средств и коммутационных оснований, их основополагающих параметров и характеристик. Определяющие факторы развития конструкций специальных (профессиональных) и электронных средств широкого пользования (бытовых).
- 11. Признаки системности конструкции электронных средств. Уровни входимости конструкции (уровни конструктивной иерархии электронных средств от нулевого до пятого).
- 12. Микросборка как подуровень 1-го конструктивного уровня электронных средств. Технология изготовления коммуникационных оснований микросборок.
- 13. Функционально-узловой, каскадно-узловой, схемно-узловой и моносхемный методы конструирования ячеек электронных средств.
- 14. Компоновка электронных средств, определяющие факторы. Уровни конструктивной иерархии оптоэлектронных средств мобильной связи.
- 15. Исходные данные процесса конструирования электронных средств и коммутационных оснований. Электрические схемы электронных средств структурная, функциональная, принципиальная.
- 16. Соотношение понятий проектирование и конструирование электронных средств. Задачи, цели и техническое задание на проектирование. Средства проектирования.
- 17. Технологичность конструкции электронных средств. Качественные и количественные показатели технологичности. Комплексный показатель оценки технологичности конструкции электронных средств.

- 18. Коммуникационные основания электронных средств в виде печатных и интегральных плат. Разновидности плат по технологии изготовления.
- 19. Тонкопленочные и толстопленочные технологии формирования проводников и пассивных компонентов на поверхности интегральных плат.
- 20. Основные требования к проектированию печатного монтажа, особенности трассировки и расчета элементов печатного монтажа. Преимущества и недостатки диэлектрических оснований печатных плат из гетинакса, текстолита и стеклотекстолита.
- 21. Многослойные печатные платы. Особенности монтажа электро-радиоэлементов и устройств функциональной электроники на печатных платах.
- 22. Основные способы охлаждения электронных средств. Элементы локального охлаждения функциональных ячеек электронных средств. Тепловые трубки. Типовые схемы охлаждения матриц лазерных диодов.
- 23. Внешние воздействия на электронные средства: вибрации, удары, ионизирующие излучения. Их характеристики и влияние на элементы конструкции и компоненты. Конструкторские способы виброзащиты элементов и узлов электронных средств.
- 24. Помехоустойчивость, радиационная стойкость и радиационная устойчивость электронных средств.
 - 5.3. Самостоятельная работа обучающегося включает следующие виды деятельности:
- систематическое изучение учебного материала по конспектам лекций, по учебной и научной литературе;
 - изучение методических указаний и подготовка к практическим и лабораторным занятиям;
- подготовка эссе (статьи) по индивидуальному заданию темы самостоятельного исследования;
 - подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации.

Темы эссе, рефератов, статей, практико-ориентированных заданий

Организационная структура университета и промышленного предприятия. Производственный и технологический процессы изготовления электронных средств.

Объект, предмет, цель и результат научного исследования в области микроэлектронного производства.

Виды материи и их составляющие. Модели физического состояния вещества и поля.

Виды производства; основной и вспомогательный производственные процессы; основные и неосновные средства микроэлектронного производства.

Виды изделий, области применения и преимущества средств оптоэлектроники.

Дефекты кристаллических решеток по Френкелю и по Шоттки; растворы внедрения и замещения.

Характеристика ионной, ковалентной и металлической связей в кристаллах. Природа дисперсионной, ориентационной и индукционной составляющих взаимодействия сил Ван-дер-Ваальса.

Типы межзонных и внутризонных энергетических переходов электронов в атоме с испусканием и поглощением квантов света.

Термо- и фотоэлектронная эмиссия. Электровакуумные лампы. Вакуумные фотоэлектронные умножители.

Генерация и рекомбинация носителей заряда в полупроводниках; длина свободного пробега. Электронно-дырочные переходы.

Виды обратимого и необратимого пробоя р-п переходов; вольтамперная характеристика р-п перехода при пробое. Гетеропереходы, их структура и основные энергетические диаграммы.

Микроэлектронные технологии - полупроводниковая, пленочная, гибридная и смещанная технологии изготовления. Тонкопленочные и толстопленочные групповые интегральные технологии.

Особенности исполнения чертежа печатной платы и сборочных чертежей ячеек электронных средств. Преимущества комбинированного позитивного метода изготовления печатных плат.

Основные способы охлаждения электронных средств. Элементы локального охлаждения оптоэлектронных средств; тепловые трубки.

Типовые схемы охлаждения матриц лазерных диодов.

Общие системы охлаждения электронных средств. Особенности проектирования естественной и принудительной вентиляции электронных средств.

Схемы компоновок стоек управления электронных средств.

Внешние воздействия на электронные средства: вибрации, удары, ионизирующие излучения; их характеристики и влияние на элементы конструкции и компоненты.

Радиационная стойкость и радиационная устойчивость электронных средств.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год	КНИГООБЕСПЕЧЕНН
	издания	ОСТЬ
		Наличие в
		электронном каталоге
		ЭБС
Основная литература		
1. Головицына М.В. Проектирование радиоэлектронных средств на основе	2020	https://www.iprboc
современных информационных технологий: учебное пособие / Головицына		kshop.ru/97578.ht
М.В — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий		ml
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 503 с. — ISBN 978-5-4497-0690-4.		http://www.iprbook
		shop.ru/22439
2. Наноэлектроника: теория и практика: учебник / В.Е. Борисенко [и др.] —	2020	https://www.iprboo
Москва: Лаборатория знаний, 2020. — 367 с. — ISBN 978-5-00101-732-5.		kshop.ru/88978.ht
		ml
3. Фролов, В. А. Электронная техника: учебник: в 2 ч. [Электронный ресурс] / В.	2015	http://www.student
А. Фролов. — Ч. 1: Электронные приборы и устройства. — М.: УМЦ ЖДТ, 2015.		ibrary.ru/book/ISB
— 532 c. ISBN 978-5-89035-835-6.		N9785890358356.h
		tml
4. Шеин А.Б. Методы проектирования электронных устройств / Шеин А.Б.,	2013	https://www.iprboo
Лазарева Н.М — Москва: Инфра-Инженерия, 2013. — 456 с. — ISBN 978-5-		kshop.ru/13540.ht
9729-0041-1.		ml
5. Муромцев, Д. Ю. Конструирование узлов и устройств электронных средств и	2013	https://www.studen
учебное пособие / Д. Ю. Муромцев, И. В. Тюрин, О. А. Белоусов Ростов н/Д		tlibrary_ru/book/IS
Феникс, 2013 540 с. (Высшее образование) - ISBN 978-5-222-20994-3.		BN9785222209943
		.html
Дополнительная литература		
1. Ланин, В. Л. Технология производства электронных средств: учебное пособие	2019	https://www.studen
/ В. Л. Ланин, А. А. Хмыль Минск : Вышэйшая школа, 2019 455 с ISBN		tlibrary.ru/book/IS
978-985-06-3167-1.		BN9789850631671
		.html
2. Малюков, С. П. Схемотехническое проектирование электронных средств:	2019	https://www.studen
учебное пособие / С. П. Малюков, А. В. Саенко, А. В. Палий Ростов н/Д:		tlibrary.ru/book/IS
ЮФУ, 2019 92 с ISBN 978-5-9275-3380-0.		BN9785927533800
		.html
3. Скарпино, М. Разработка печатных плат в EAGLE / Скарпино М., пер. с анг.	2018	https://www.studen
А. Э. Бряндинского Москва : ДМК Пресс, 2018 370 с ISBN 978-5-97060-	2010	tlibrary.ru/book/IS
479-3.		BN9785970604793
		.html
4. Лопаткин, А. Проектирование печатных плат в системе Altium Designer : учеб.	2017	https://www.studen
пособие для практических занятий / Лопаткин А. 2-е изд., перераб. и доп	2017	tlibrary.ru/book/IS

		,,html
5, Мылов, Г. В. Печатные платы : выбор базовых материалов / Мылов Г. В.	2016	https://www.studen
Москва: Горячая линия - Телеком, 2016 172 с ISBN 978-5-9912-0486-6.		tlibrary_ru/book/IS
		BN9785991204866
		.html
6. Камышная, Э. Н. Конструкторско-технологические расчеты электронной	2014	https://www.studen
аппаратуры: учеб. пособие/ Э. Н. Камышная, В. В. Маркелов, В. А. Соловьев -		tlibrary.ru/book/IS
Москва: Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014 165 с ISBN 978-5-		BN9785703839430
7038-3943-0.		html
7. Певницкий, С. Ю. Разработка печатных плат в NI Ultiboard / Певницкий С. Ю.	2012	https://www.studen
- Москва: ДМК Пресс, 2012 256 с ISBN 978-5-94074-789-5.		tlibrary.ru/book/IS
		BN9785940747895
		.html
8. Юзова, В. А. Основы проектирования электронных средств. Конструирование	2012	http://www.studentl
электронных модулей первого структурного уровня [Электронный ресурс] / В. А.		ibrary.ru/book/ISB
Юзова Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012 208 с.		N9785222209943.h
		tml

6.2. Периодические издания

- 1. Проектирование и технология электронных средств. ISSN 2071-9809.
- 2. Квантовая электроника. ISSN 0368-7147.
- 3. Динамика сложных систем XXI век. ISSN 1999-7493.
- 4. Радиотехнические и телекоммуникационные системы. ISSN 2221-2574.

6.3. Интернет-ресурсы

- 1. AltiumDesigner, SolidWorks, MultiSim комплексная система автоматизированного проектирования электронных средств;
- 2. <u>КОМПАС-3D</u> семейство <u>систем автоматизированного проектирования</u> с возможностями оформления проектной и конструкторской документации согласно стандартам серии <u>ЕСКД</u> и <u>СПДС</u>.
- 3. http://www.studentlibrary.ru/book/, http://www.iprbookshop.ru/ электронные библиотечные системы.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации дисциплины «Проектирование коммуникационных оснований электронных средств в наноэлектронике» имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий практического/лабораторного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы.

Практические/лабораторные занятия проводятся в лабораториях физики и компьютерных классах прикладной математики Института прикладной математики, физики и информатики ВлГУ (100-3, 104-3, 106-3, 107-3, 1226-3, 5116-3 или в аналогичных аудиториях в зависимости от сетки расписания).

Перечень используемого лицензионного программного обеспечения:

- 1) GPSS World Student Version (свободно распространяемое);
- 2) MS Word;
- 3) MS PowerPoint;
- 4) MS Visual Studio.

Рабочую программу составил Давыдов Н.Н., профессор кафедры ФиПМ
(ФИО, должность, подпись)
Рецензент Генеральный директор ООО «ВладИнТех»
(место работы, должность, ФИО, подпись) Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ФиПМ Протокол №1 от 30.08.2021 года Заведующий кафедрой
С.М. Аракелян
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 28.03.01 Протокол №1 от 30.08.2021 года
Председатель комиссии С.М. Аракелян
(ФИО, должность, подпись)
ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа одобрена на 20 <u>Д</u> / 20 В учебный года Протокол заседания кафедры № <u>Лования</u> года Заведующий кафедрой_
Рабочая программа одобрена на 20 / 20 учебный года Протокол заседания кафедры № от года Заведующий кафедрой
Рабочая программа одобрена на 20 / 20 учебный года Протокол заседания кафедры № от года Заведующий кафедрой